

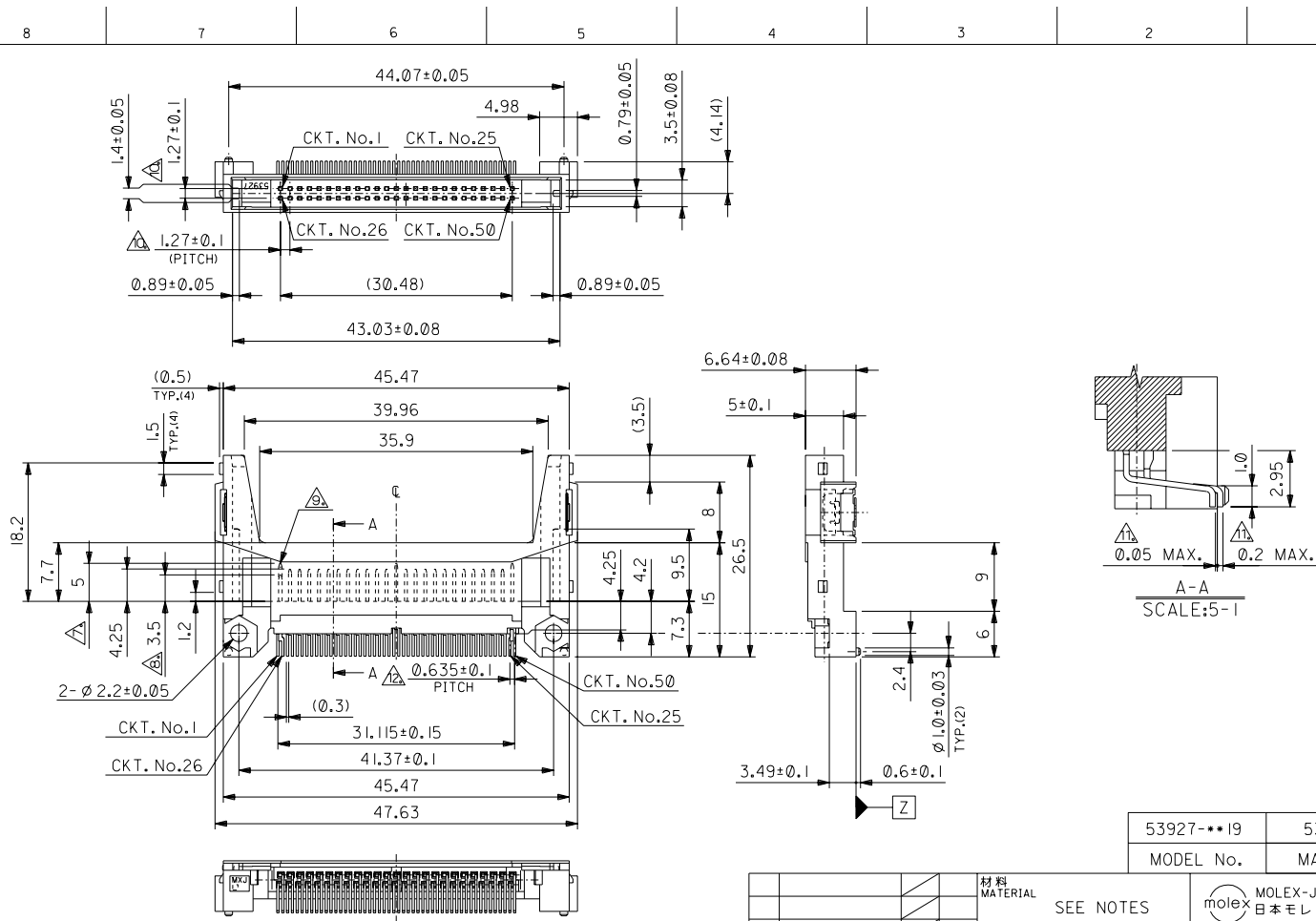
DWG. NO. SD-53927-001

E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A



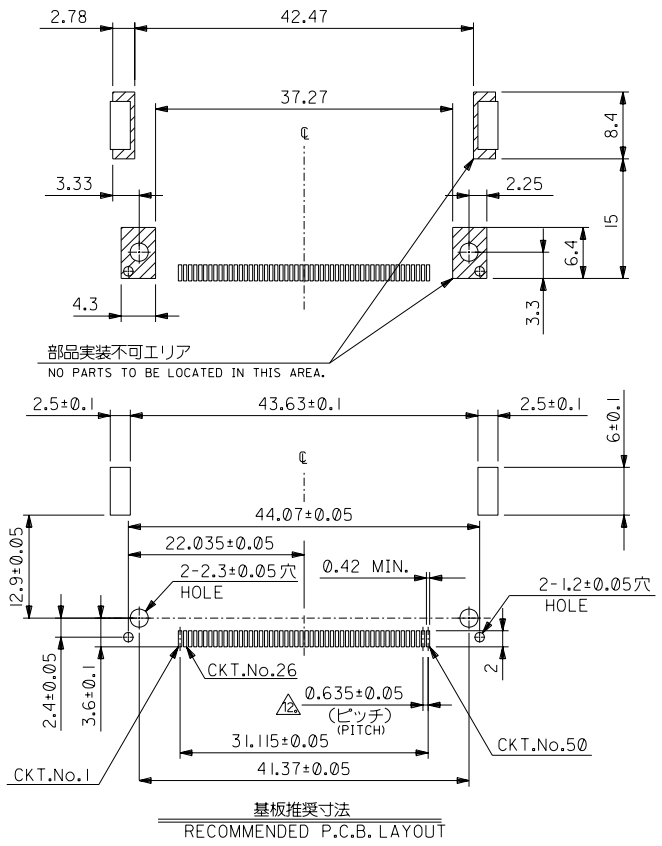
53927-***19	53927-5019
MODEL No.	MATERIAL No.

材料 MATERIAL		SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH		SEE NOTES	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
被覆外径 INS. RANGE		—	TITLE 名称
角度 ANGLE		±3°	CFA CARD CONN.
30以上 OVER		±0.3	50P HEADER ASS'Y
10以上 未過 UNDER		±0.25	(REVERSE TYPE)
10未過 UNDER		±0.2	-LEAD FREE-
一般公差 GENERAL TOLERANCES		0	DWG. NO. SHEET 1 OF 2 REV
新規格作成 (12004-4268)		1.1	SD-53927-001 0
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	
		CHK. DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53927-001
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

- 注)
 NOTES 1. 材質
 MATERIAL
 ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0
 HOUSING: LCP G.F. UL94V-0
 ピン：リン青銅
 PIN: PHOSPHOR BRONZE
 ネール：リン青銅
 NAIL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様
 PLATING
 PIN 接点部：パラジウムニッケル下地、金メッキ
 CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni
 半田付け部：錫メッキ
 SOLDER TAIL AREA: TIN
 下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL
- NAIL 錫メッキ
 TIN
 下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL
3. 推奨基板厚：t0.8 MIN.
 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t0.8 MIN.
4. 適合カード厚
 RECOMMENDED CARD THICKNESS
 接続部：3.3±0.1
 CONNECTING AREA: 3.3±0.1
5. 適合カード幅：42.8±0.1
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1
6. ハウジング色：白
 HOUSING COLOR: WHITE
- △寸法適用極：1,13,38,50
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,13,38 AND 50.
- △寸法適用極：25,26
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.
 ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ0.1 MAX.とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.
- △ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.
 ソルダータールは、Z面を基準とし上へ0.05下へ0.2の範囲にあり、且つソルダータールの平坦度は、0.15 MAX.とし、タール先端にて測定する。
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.15. MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.
- △公差非累積
 NON-CUMULATIVE
13. 本製品は 53927-**10 の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927-**10.



角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL	—	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE- DWG. NO. SHEET 2 OF 2 REV SD-53927-001 0
30°以上 OVER	±0.3				仕上げ FINISH	—	
10°以上 OVER 30°未満 UNDER	±0.25				適用電線範囲 WIRE RANGE	—	
10°未満 UNDER	±0.2	0	SEE SHEET 1 OF 2	11/17 M.S	被覆外径 INS. RANGE	—	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	CHK. DATE	DRAWN BY 04/05/17 T.UENO APP'D BY 04/05/17 M.SASAO 尺度 SCALE 2 - 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32